# 用磁控溅射和真空硒化退火方法制备高质量 的铜铟硒多晶薄膜\*

谢大弢 范 夔 王莉芳 朱 凤 全胜文 孟铁军 张保澄 陈佳洱

(北京大学物理学院重离子物理研究所北京 100871) (2001年11月1日收到 2002年1月30日收到修改稿)

用双靶磁控溅射的方法在玻璃衬底上制备了 Cu<sub>11</sub> In, 合金薄膜,然后将 Cu<sub>11</sub> In, 合金薄膜封闭在石墨盒中进行 真空硒化退火得到 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜.用扫描电子显微镜 SEM )和 X 射线粉末衍射 (XRD )对 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜进行了表征,结 果表明 CuInSe, 薄膜具有单一的晶相,均匀、致密的结构,以及粒径超过了 3µm 的晶粒.

关键词:铜铟硒多晶薄膜,磁控溅射,真空硒化,太阳能电池 PACC:8115C

# 1.引 言

铜铟硒太阳能电池(CIS)是从 20 世纪 80 年代 初发展起来的多晶薄膜电池.它具有高效、廉价、稳 定的特点,是本世纪最有发展前途的太阳能电池之 一.近年来,该电池的效率一直在不断的提高,到 1996年电池的效率已超过了多晶硅太阳能电池的 效率 17%<sup>[1]</sup>,而 2000 年电池的效率又达到 18.8%<sup>[2]</sup>,预计在本世纪该电池的效率会超过 20% 并向单晶硅电池的效率接近.

多年来,提高铜铟硒吸收薄膜的质量一直是提 高 CIS 电池效率的关键.大量的研究发现,高质量的 CIS 吸收层应具备两方面的性质,一是多晶薄膜应 有较好的致密性及较大的晶粒(平均粒径大于 2μm) 以尽量减少晶界缺陷,二是薄膜应具有富铜(Curich 和富铟(In-rich)的双层结构以形成 p型半导体 区和 n型半导体区,在 CIS 的表面形成 p-n 结<sup>[3,4]</sup>.迄 今为止,人们已采用了多种方法来达到这两种要求, 具体的方法有铜、铟、硒三源蒸发方法<sup>[5,6]</sup>;铜、铟两 靶溅射加真空硒化退火方法<sup>[7]</sup>,铜、铟电解沉积加硒 化退火方法<sup>[8]</sup>,气相沉积(VCD)和分子束外延方法 等<sup>[9]</sup>,但最成功的方法一直是铜、铟(镓),硒三源蒸 发方法,用该方法制备的电池的效率已达到了 18.8%. 目前,在国内已有一些单位开展了太阳能光电转换的薄膜的研究<sup>[10—13]</sup>.而制备铜铟硒电池的方法 主要是蒸发方法,电池的效率在7%—9%之间<sup>[14—16]</sup>.

与蒸发方法相比,溅射方法在制备 CIS 薄膜上 有很多优点,尤其是在组分的控制上,溅射方法更能 满足制备 Cu-rich 和 In-rich 双层结构的要求,同时该 方法还适合于大面积的生产.真空硒化退火方法则 是近年来发展起来的有效硒化方法之一,它不但有 设备简单、毒性小和易于大面积生产的特点,而且结 合溅射方法制备高品质的 CIS 薄膜特别有效.本文 用两靶溅射的方法制备了 Cu-rich 的 Cu-In 合金薄 膜,然后用真空硒化退火的方法将 Cu-In 预制薄膜 转变成 CIS 薄膜,目的是寻找制备高质量 CIS 多晶 薄膜的有效途径.同时,我们也对热蒸发加真空硒化 退火和溅射方法加真空硒化退火的方法制备的 CIS 薄膜进行了比较研究,以确定两种方法的优劣.

### 2.实验

2.1. 薄膜的制备

1. 两靶磁控溅射 Cu-In 预制薄膜

三靶磁控溅射溅射的装置如图 1 所示 ,三靶的 位置在同一个球面上 ,样品衬底到三个靶的距离相

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号:10175006)资助的课题.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>E-mail :xiedatao@hotmail.con tel :62755408

等 均为 20cm.本实验用了两个靶位(另一个靶位可 同时进行 Ga 的溅射),其中铟放在底部的位置.在 溅射时为了增加薄膜的均匀性衬底可以在水平方向 转动.具体的实验条件如下:无氧铜靶的直径 70mm, 厚度 2.5mm 纯度 99.99%;捆靶的直径 70mm,厚度 2.5mm 纯度 99.99%;用 3mm 厚的普通载玻片玻璃 作衬底,尺寸为 2cm×3cm.真空度本底 < 1.2×10<sup>-4</sup> Pa,溅射时的真空度为 2.6Pa,Ar 气的流量 14.5ppm; Cu 靶的溅射电压为 300V、电流 90—150mA,In 靶的 溅射电压为 400V、电流 90—150mA.



图 1 三靶磁控溅射溅射的装置示意图 1.样品旋转马达 2.玻璃衬底 3.铜靶; 4. 铟靶 5 6,7. 溅射电源;8. 质量流量 计 9. 真空系统;10.Ar 气阀门

2. 双源蒸发的方法制备 Cu-In 预制薄膜

双源蒸发装置的两个蒸发源在同一水平面上, 蒸发源与衬底的距离为 20cm.为了增加薄膜的均匀 性衬底可以在水平方向转动.具体的实验条件如下: 无氧铜和铟的纯度为 99.99%;衬底用 3mm 厚的普 通载玻片玻璃;蒸发时真空度为 10<sup>-4</sup> Pa.蒸发舟为 金属 Mo 制造,温度由电流源和热电偶共同控制.Cu 的蒸发温度为 1100℃,电流 180A;In 的蒸发温度 600℃、电流为 80A.

3. 真空硒化退火制备 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜

真空硒化退火装置如图 2 所示,Cu-In 预制薄膜 和 Se 粉放在一个密闭的石墨盒中;石墨盒放在管式 炉的石英管中,石英管可以用机械泵抽真空.具体的 硒化退火条件为:真空度 1Pa,100℃预热 30min; 200℃加热 60min 500℃退火 60min.

#### 2.2. 样品的表征

Cu-In 和 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜的厚度用台阶仪测量;Cu-In 合金和 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜的晶体结构用 Rigaku Dmax-



图 2 真空硒化退火装置示意图(Cu-In 预制薄膜和 Se 粉放在 一个密闭的石墨盒中 石墨盒放在管式炉的石英管中 石英管 可以用机械泵抽真空)

2400 型 X 射线粉末衍射器测量,测量时采用 Cu 转 靶,电压 40kV,X 射线的波长为 0.154056nm,扫描范 围 2θ 为 15—90°,步长 0.02°;CuInSe<sub>2</sub> 薄膜的表面形 貌用日立 S-531 型扫描电子显微镜 SEM 测量.吸收 光谱用岛津 UV3100 分光光度计测量.用 X 射线电 子能谱(XPS)测量 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜中 Cu ,In Se 的配比, 实验在 VG-ESCA-LAB-5 多功能电子能谱仪上进行, 测量时采用 A1靶、电压 9000V、电流 18.5mA.

## 3. 实验结果与讨论

#### 3.1. 蒸发和溅射薄膜的速率控制

我们用台阶仪测量不同溅射功率时薄膜的厚度,然后用溅射的时间加以平均得到溅射的速率,结果如图3所示.可以看出,Cu,In的溅射速率与电源的功率基本成线性关系;当Cu溅射功率从19.26W增加到105.6W时,溅射的速率从0.28nm/min增加到6.76nm/min;In的溅射功率从19.26W增加到56.58W时,溅射的速率从1.52nm/min增加到4.9nm/min.比较而言,在相同溅射功率的情况下In的溅射速率大约是Cu的1.5倍左右,这主要与In的熔点低有关,在溅射过程中,锢靶的溅射功率范围选择在40—50W的范围内,铜的溅射功率选择在40—60W之间.利用铜、铟的溅射速率与溅射功率线性关系,可以方便地控制溅射的速率及溅射的时间,以同时满足制备Cu-rich和In-rich双层结构的要求并控制Cu-In薄膜的厚度.

此外,我们还研究了用热蒸发的方法制备 Cu-In 薄膜的速率,结果表明用 5g 左右的 Cu 样品,在蒸发 电源电流为 180A,蒸发温度为 1100℃的条件下,Cu 薄膜的生长速率为 2000nm/min 左右;而用 5g 左右 的 In 样品,在蒸发电源电流为 80A,蒸发温度为



图 3 Cu, In 溅射速率测量结果(Cu的溅射功率范围在 20—110W, In 的溅射功率范围在 20—60W 溅射功率大约 60W时, 铟靶开始发热并溶化)

600℃的条件下,In 薄膜的生长速率为 4000nm/min 左右.在我们的实验条件下(蒸发舟的面积 2.5 cm × 1.5 cm,蒸发样品的重量 5g 左右),蒸发的时间不能 超过 1 min,否则样品会全部蒸发干净.比较而言,用 我们现有的装置蒸发的速率要比溅射的速率大 300—400倍,制备薄膜所用的时间也比较短只有溅 射时间的 1/400.这样的条件在保证薄膜的均匀性、 致密性及 Cu,In 成分的定量控制方面都是很不 利的.

3.2.Cu/In 比例与 XRD 结果 晶相的控制

在研究溅射速率的基础上,我们选择了制备 Curich 的 CulInSe<sub>2</sub> 薄膜的溅射条件:Cu 靶的溅射电压 398V、电流 150mA、功率 48.63W、溅射速率 2.48nm/ min Jn 靶的溅射电压 413V、电流 117mA、功率 48W、溅 射速率 4.08nm/min.溅射时间为 150min.按照该条件 Cu-In 薄膜中铜铟的摩尔比 N<sub>Gu</sub>/N<sub>la</sub>应为

N<sub>Cu</sub>/N<sub>In</sub> =( V<sub>Cu</sub> × t × Cu 的密度 /Cu 分子量 )( V<sub>In</sub> × t × In 的密度 /In 分子量 )

= 1.35, 其中,Cu的密度 8.94g/cm<sup>3</sup>,分子量 63.546,In 的密 度 7.31g/cm<sup>3</sup>,分子量 114.818,t 为溅射时间,V 为溅

射速度.

图 4 分别给出了按照上述条件制备的 Cu/In 合 金薄膜和真空硒化退火后得到的 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜的 XRD 图谱.经台阶仪测量 CuIn 合金薄膜的厚度为 1µm ,CuInSe<sub>2</sub> 薄膜的厚度为 3µm.图 4( a )中的 29.37° 和 42.08°峰代表了 Cu<sub>11</sub> In<sub>9</sub> 的结构 ,34.54°的峰代表 了 CuIn<sub>2</sub> 的结构.图 4( b )中的 26.59° ,44.24° ,52 ,45°



图 4 ( a )Cu-In 合金薄膜 XRD 谱 ( b )真空硒化退火后 Cu-In 合金薄膜的 XRD 谱

峰代表 CuInSe<sub>2</sub> 相的黄铜矿结构,27.73°,44.59°, 52.97°则代表了 Cu<sub>2-x</sub> Se 相的出现,可以发现 Cu-In 合金薄膜中的晶相主要有 Cu<sub>11</sub> In<sub>9</sub> 和 CuIn<sub>2</sub> 两相,而 且前者占主要的比例,在 Cu-In-Se 薄膜中的晶相主 要有 CuInSe<sub>2</sub> 和 Cu<sub>2-x</sub> Se 两相,但 CuInSe<sub>2</sub> 占了主要 的比例.

同时,我们还用 XPS 对铜铟硒薄膜中的铜、铟、 硒元素的配比进行了研究.结果如图 5 所示.在 XPS 谱中分别出现了 Cu(2p<sub>1/2</sub>),Cu(2p<sub>3/2</sub>),In(3d<sub>5/2</sub>),In (3d<sub>3/2</sub>)的双峰和 Se(3d)的单峰,相应的峰面积分别 为 2707.3 2647.8 和 1091.1 相应的敏感因子分别为 3.5 A.45 和 0.9.Cu,In,Se 的原子数与峰面积/敏感 因子成正比应为 1.30:1:2.04.

多方面的研究结果表明:要制备高质量的 CuInSe<sub>2</sub>薄膜在 Cu-In 预制膜中产生 Cu-rich 相是非 常重要的,原因是 Cu-rich 相的存在不但可以保证 CuInSe<sub>2</sub> 具有 p型半导体的性质,而且在硒化退火的 过程中可以产生 Cu<sub>2-x</sub>Se 相,而 Cu<sub>2-x</sub>Se 相又会产生 催化作用使 CuInSe<sub>2</sub> 在重结晶的过程中产生大的晶 粒<sup>[17]</sup>.在我们的实验中 Cu/In 的比例控制在 1.35 左

另一方面,我们也改变了铜靶和铟靶的溅射功 率以制备富铟和具有化学配比的 CuInSe<sub>2</sub> 各种薄 膜,XDR 的测量结果表明这些薄膜有很好的富铟相 和化学计量配比的 CuInSe<sub>2</sub> 晶相.这说明用溅射的 方法制备 Cu-rich 和 In-rich 的铜铟硒双层膜结构是 非常方便的.



图 5 CuInSe, 薄膜的 XPS 谱

#### 3.3. 硒化退火与 SEM 的形貌 ,晶粒大小的控制

真空硒化退火程度按照下面的条件进行:25— 250℃用 60min 均匀升温;250℃恒温 60min;250— 500℃用 60min 均匀升温;500℃恒温 60min.退火结 束后要继续保持真空度使硒化室自然冷却到室温.

硒化的机理可以用下列的方程表示:

Cu<sub>11</sub> In<sub>9</sub> + CuIn<sub>2</sub> + Se→CuSe + In<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>(低温)<sub>⇒</sub> CuInSe<sub>2</sub> + Se<sub>2</sub>(气体)(高温).

在 250℃ Se 蒸气开始与 Cu<sub>11</sub> In<sub>9</sub> 和 CuIn<sub>2</sub> 反应产 生 CuSe 和 In<sub>2</sub> Se<sub>3</sub> ;从 300℃开始 CuSe 开始分解并与 In<sub>2</sub> Se<sub>3</sub> 反应产生 CuInSe<sub>2</sub> ,在 500℃ CuInSe<sub>2</sub> 产生重结 晶过程产生较大晶粒和单一晶相 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜.

研究结果表明 CuSe 对 CuInSe<sub>2</sub> 晶相的产生及生 长有催化作用<sup>[18,19]</sup>, Cu-rich 的 Cu/In 相有益于 CuInSe<sub>2</sub> 多晶薄膜中产生较大的晶粒及致密的晶界. 而封闭的石墨盒真空硒化可以提高 Se 蒸气的密度 和扩散自由程,也有利于 CuInSe<sub>2</sub> 相的形成和生长.

图 6(a) 是硒化后的 Cu-In 溅射薄膜的 SEM 图像 (其相应的 XRD 谱已在图 4 中给出),从图中可以看 出 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜的形貌是致密的、均匀的多晶薄膜, 而且晶粒的直径已超过了 3µm.

图 (ć b)中的 SEM 照片是用热蒸发方法制备的 Cu-In 薄膜经真空硒化退火后得到的 CuInSe<sub>2</sub> 形貌, 从中可以看出图中的晶粒结晶度不是很好,薄膜的 致密性也非常差.在制备过程中我们首先选取的蒸 发条件主要是以铜的熔点为标准,让铜的蒸发温度 刚刚超过其熔点,铟的蒸发速度与铜的蒸发速度相 匹配.这样 Cu 的蒸发速度已经尽可能小了,但与溅 射的速度相比仍有 400 倍的差异.图中薄膜的形貌 说明较快的蒸发速度会使 Cu ,In 快速沉积到衬底上 而来不及在表面重结晶,其结果是使薄膜表面产生 非常不致密的形貌.

#### 3.4. 铜铟硒薄膜的能隙

图7 是铜铟硒薄膜的吸收光谱,其吸收边为 1.212μm,对应的能隙为1.023eV.该结果与 CuInSe<sub>2</sub> 的能隙1.04eV相比有一定的差异,其原因是由于该 薄膜是 Cu-rich 的 CuInSe<sub>2</sub>相,与化学配比的 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜不完全相同.



图 6 (a) 硒化后的 Cu-In 溅射薄膜的 SEM 图像(CuInSe<sub>2</sub> 薄膜 的形貌是致密的、均匀的,晶粒的直径超过了  $3\mu$ m)(b)热蒸 发的方法制备 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜的 SEM 照片





# 4.结 论

我们用溅射加真空硒化退火的方法制备了 Curich 的 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜并通过 XRD ,XPS SEM 和吸收光 谱等方法对薄膜的成分和质量进行了分析.研究结 果表明(1)用两靶磁控溅射的方法可以精确地控制 Cu ,In 的比例并制备出均匀的、致密的 Cu-In 合金薄 膜.(2)用真空硒化退火的方法可以对 Cu-In 合金薄 膜进行硒化得到 CuInSe<sub>2</sub> 薄膜.在 Cu/In = 1.35 的条 件下 ,真空硒化退火可以使 CuInSe<sub>2</sub> 重结晶产生晶 粒大于  $3\mu$ m 多晶薄膜 ,且薄膜的致密性和均匀性都 很好.(3)磁控溅射较热蒸发方法在溅射时间和溅射 速度方面有较强的控制能力 ,得到的薄膜在均匀性 和致密性方面均有较好的性质.(4)CuInSe<sub>2</sub> 薄膜能 隙在 1.023eV 左右.

- [1] Tuttle J R , Ward J S , Berens T A , Contreras M A , Ramanathan K R , Tennant A L , Keane J , Cole E D , Emery K and Noufi R 1996 Mater . Res. Soc. Symp. Proc. 143 426
- [2] Contreras M A, Egaas B, Ramanatha K, Hiltner J, Swartzlander A, Hasoon F and Noufi R 1999 Prog. Photov. Res. Appl. 5 311
- [3] Mickelsen R A and Chen W S , 1980 Appl . Phys . Lett . 371 36
- [4] Hedström J, Ohlsen H, Bodegard M, Kylner A, Stolt L, Hariskos D, Ruckh M and Schock H W 1993 In Proc.23rd IEEE Photovolt. Spec. Conf. (IEEE, New York) p 364
- [5] Kessler J, Schmid D, Dittrich H and Schock H W 1994 In Proc. 12th Europ. Photovolt. Solar Energy Conf. ed by Hill R, Palz W, Helm P(Stephens, Bedford) p 648
- [6] Gabor A M, Tuttle J R, Albin D S, Contreras M A, Noufi R and Hermann A M 1994 Appl. Phys. Lett. 198 65

- [7] Adurodjia F O , Song J , Kim S D , Kwon S H , Kim S K , Yoon K H and Ahn B T 1999 Thin Solid Films 338 13
- [8] Lincot D, Guillemoles J F, Cowaches P, et al 1994 1st World Conf. PV Energy Conv. in 24th IEEE PV Specialists Conf., Hawaii, December 5-9, 1994, 136
- [9] Tiwari A N , Krejci M , Hang F J and Zogg H 2000 Thin Solid Films 361-362 41
- [10] Zhao Q, Zhu F, Wang L F, Meng T J, Zhang B C and Zhao K 2001
  Acta Phys. Sin. 10 1390(in Chinese ] 赵 坤、朱 凤、王莉芳、
  孟铁军、张宝澄、赵 夔 2001 物理学报 10 1390]
- [11] Yang Z W, Hang S H, Yang L T, Zhao J Q, Ma J and Ma H L
  2000 Acta Phys. Sin. 60 1196( in Chinese ) 杨志伟、韩圣浩、杨
  林田、赵俊卿、马 瑾、马洪磊 2000 物理学报 60 1196 ]
- [12] Li G H , Wu Y C and Zhang L D 2001 Chin . Phys. 10 148

- [13] Shi J J , Huang S Y , Chen K J , Huang X F and Xu J 2001 Chin . Phys. 10 748
- [14] Shun Y et al 2001 Journal of Solar Energy 27 19X in Chinese ] 孙 云等 2001 太阳能学报 27 192 ]
- [15] Li C J, Zhu J Z, Fei H D, Shun J and Zhou Z H 1998 Journal of Solar Energy 4 19 (in Chinese) 李长健、朱践知、飞海东、孙 健、周桢华 1996 太阳能学报 4 197]
- [16] Ji B H and Wang W L 1999 Journal of Solar Energy 102[季秉厚、 王万录 1999 太阳能学报(特刊)102]
- [17] Klenk R, Walte T, Schock H W and Cahen D 1993 Adv. Mater. 114 5
- [18] Lincot D, Guillemoles J F, Cowache P et al 1994 1st World Conf. PV Energy Conv. in 24th IEEE PV Specialists Conf., Hawaii, December, 5–9, 1994, p 136
- [19] Casteleyn M, Burgelman M, Depuydt B, Niemegeers A and Clemminck I, 1994 1st World Conf., PV Energy Conv., in 24th IEEE PV Specialists Conf. Hawaii, December, 5–9, 1994, p 230

# Growth of high-quality CuInSe<sub>2</sub> polycrystalline films by magnetron sputtering and vacuum selenisation \*

Xie Da-Tao Zhao Kui Wang Li-Fang Zhu Feng Quan Sheng-Wen Meng Tie-Jun Zhang Bao-Cheng Chen Jia-Er (Institute of Heavy Ion Physics, College of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China) (Received 1 November 2001; revised manuscript received 30 January 2002)

#### Abstract

High-quality CuInSe<sub>2</sub> thin films have been prepared using a two stages process. Cu and In were co-deposited onto glass substrates by magnetron sputtering method to produce a predominant Cu<sub>11</sub> In<sub>9</sub> phase. The alloy films were selenised and annealed in vacuum at different temperature in the range of 200—500 °C using elemental selenium in a closed graphite box. X-ray diffraction and scanning electron microscopy were used to characterize the films. It was found that the polycrystalline and single-phase CuInSe<sub>2</sub> films were uniform and densely packed with a grain size of about  $3.0\mu m$ .

**Keywords**: CuInSe<sub>2</sub> polycrystalline thin films , magnetron sputtering , vacuum selenisation **PACC**: 8115C

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China( Grant No. 10175006 )